

98年6月3~5日

金屬中心科技專案研發成果
暨 創新育成發表會

金工開物
牛轉乾坤

指導單位：經濟部技術處
協辦單位：經濟部中小企業處
承辦單位：金屬工業研究發展中心

98年6月3日 (星期三)

● 單元A 光電 / 3C零組件產業應用技術

時 間	議 題	主 持 人／主 講 人
08:30～09:30	報到	
09:30～09:40	主席致詞	黃啟川 董事長
09:40～10:00	金屬中心能量介紹	郭興家 執行長
10:00～10:20	我國光電產業展望	林志隆 副執行長
10:20～10:40	平面顯示器製程設備與零組件市場發展現況	盧素涵 分析師/產業研究組
10:40～10:50	休 息	
10:50～11:10	突起物影像疊合之檢測技術	葉光明 專案經理/智慧系統組
11:10～11:40	1. 複雜曲面板材液壓成形技術 2. 金屬板件精微圖紋電磁成形技術	蘇子可 專案經理/製程處
11:40～12:00	1. 抗菌不銹鋼開發技術 2. 複合金屬板材開發及製品設計技術	施景祥 副組長/製程處
12:00～12:20	1. 300mm幅寬之CO ₂ Snow乾式噴洗技術 2. 軟板夾治具系統	花瑞銘 專案經理/精微成形研發處
12:20～13:20	午 餐	
13:20～14:40	技術媒合(A)－ 300mm幅寬之CO ₂ Snow乾式噴洗技術	楊勝仲 副組長/生技能源組
	技術媒合(B)－ 1. 複雜曲面板材液壓成形技術 2. 金屬板件精微圖紋電磁成形技術	李明富 工程師/金屬成形組 鄭東辰 工程師/金屬成形組
13:20～14:40	實驗室參觀－自動檢測設備技術實驗室 實驗室參觀－精微模具及成形實驗室	曾健明 工程師/智慧系統組 許富銓 工程師/模具組 林志浩 工程師/精密成形系統組

98年6月4日 (星期四)

● 單元B 機械與自動化產業應用技術成果發表

時 間	議 題	主 講 人
08:30～09:10	報到	
09:10～09:20	主席致詞	伏和中 副執行長
09:20～09:40	金屬表面處理產業技術整合發展動向	陳仲宜 分析師/產業研究組
09:40～10:10	精微加工技術-- 1. 微雷射加工技術 2. 精微彎曲成形技術 3. 直流式精微電化學加工製程與設備開發技術	林英傑 副處長/精微成形研發處
10:10～10:30	水冷式微型泵開發-- 1. 水冷式散熱模組用微型泵浦開發關鍵技術 2. 泵浦微馬達整合設計技術 3. 流體動壓軸承潤滑流場分析技術	吳春甫 副處長/精微成形研發處
10:30～10:50	精微齒輪開發-- 1. 精微零件成形技術 2. 漸開線齒形設計技術 3. 行星齒輪組動力與強度分析技術	魏江銘 組長/精密成形系統組
10:50～11:00	休 息	
11:00～11:20	1. 超臨界流體萃取實驗設備技術 2. 影像伺服閉迴路精密定位技術 3. 夾持移載定位系統技術	吳永成 組長/智慧系統組
11:20～11:40	精微板材沖切基本參數條件技術	蔡明岳 副組長/智慧系統組
11:40～12:00	快速開發與驗證分析技術	侯博勳 工程師/檢測技術發展組
12:00～13:20	午 餐	
13:20～14:30	技術媒合(A)－ 1. 超臨界流體萃取實驗設備技術 2. 影像伺服閉迴路精密定位技術 3. 夾持移載定位系統技術	洪俊宏 工程師/生技能源組 林崇田 組長/精密機電組 薛博文 工程師/智慧系統組
13:20～14:30	技術媒合(B)－ 微型行星式傳動系統設計開發技術	魏江銘 組長/精密成形系統組
13:20～14:30	技術媒合(C)－ 水冷式散熱模組用扁薄型微泵設計開發技術	吳春甫 副處長/精微成形研發處
13:20～14:20	實驗室參觀－快速開發與驗證分析技術實驗室 實驗室參觀－精微模具及成形實驗室	侯博勳 工程師/檢測技術發展組 許富銓 工程師/模具組 林志浩 工程師/精密成形系統組

98年6月5日 (星期五)

● 單元C 汽、機車零組件應用技術成果發表

時 間	議 題	主 講 人
09:00～09:40	報到	
09:40～10:00	主席致詞	鍾自強 副執行長
10:00～10:20	金融風暴蔓延全球車市：我國汽車零組件產業未來的發展	薛乃綺 分析師/產業研究組
10:20～10:40	1. 運輸工具結構組件之輕量化設計、分析與製作 2. 懸吊結構輕量化設計分析技術	鄭炳國 組長/金屬成形組
10:40～10:50	休 息	
10:50～11:10	輕型電動車底盤輕量化技術	謝寶賢 工程師/熔鑄組
11:10～11:30	電控化底盤整合網路通訊技術	劉進展 工程師/精密機電組
11:30～12:00	1. 電磁脈衝異材銲接/成形技術 2. 濾型陰極電弧鍍膜技術	蘇子可 工程師/金屬製程研發處
12:00～13:20	午 餐	
13:20～14:30	技術媒合(A)－ 1. 電磁脈衝異材銲接/成形技術 2. 濾型陰極電弧鍍膜技術	許宏旭 工程師/銲接組 林昭憲 工程師/處理組
13:20～14:30	技術媒合(B)－ 輕量化底盤結構技術	鄭炳國 組長/金屬成形組

註：若因不可預測突發因素，大會擁有議程及講師變更權力，將於會議當天公佈